

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-033

武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月20日、2023年5月15日召开第四届董事会第二十二次会议、2022年度股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司2023年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过31.7亿元人民币；其中，公司拟对子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币6亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2023-070）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：

二、担保进展情况

为满足子公司上海精测日常经营发展需要，公司近日与上海银行股份有限公司

司市南分行（以下简称“上海银行”）签订编号为“DB22312400901”的《借款合同》，约定公司为上海精测向上海银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保合同的主要内容

（一）《借款合同》（编号：DB22312400901）

- 1、债权人：上海银行股份有限公司市南分行
- 2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司
- 3、债务人：上海精测半导体技术有限公司
- 4、保证额度有效期自 2024 年 3 月 22 日起至 2026 年 3 月 20 日止
- 5、保证最高本金限额为人民币：壹亿元整
- 6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金及实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。

8、保证期间：保证人承担的保证责任的期间为自本合同所述借款人履行债务的期限届满之日起 3 年。若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的，保证人承担保证责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起 3 年。因借款人违约，贷款人提前收回贷款时，保证期间相应提前。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 81,405.11 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2022 年 12 月 31 日净资产的 25.24%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

1、《借款保证合同》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年3月22日